

关于深南电路股份有限公司公开发行 可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会：

根据贵会 2019 年 8 月 16 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191509 号）（以下简称“反馈意见”）的要求，本次发行可转换公司债券的联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）会同深南电路股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或“深南电路”）、发行人律师北京市康达律师事务所（以下简称“律师”）和发行人会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关各方对反馈意见所列问题进行了逐项落实、核查，现对反馈意见作出如下回复，本回复中简称与《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修改部分，已用楷体加粗予以标明，请审阅。

本反馈意见的回复除特别说明外，金额均为人民币，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1、申请人本次拟募集资金不超过 106,400 万元用于数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）。请申请人：（1）说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，募集资金投入是否属于资本性支出，是否存在董事会前投入，说明本次募投项目投资规模的合理性；（2）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排；（3）说明本次募投项目与公司现有业务及前次募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目”的联系与区别，说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性，结合现有产能利用率、产销率等说明新增产能的消化措施；（4）说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性，本次募投项目在生产经营中能否与原有业务进行有效区分并做到独立核算。请保荐机构核查并发表意见。

回复：

一、说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，募集资金投入是否属于资本性支出，是否存在董事会前投入，说明本次募投项目投资规模的合理性

（一）项目投资概况

公司本次募投项目之数通二期项目的投资估算情况如下表所示：

序号	工程项目	投资估算（万元）	投资比例	是否属于资本性支出
1	建设投资	117,000	93.92%	是
1.1	设备购置及安装费用	71,000	56.99%	是
1.2	建筑及安装工程费用	46,000	36.92%	是
2	铺底流动资金	7,578	6.08%	否
合计		124,578	100.00%	-

公司本次拟将募集资金 106,400 万元全部用于数通二期项目的资本性支出部分，募集资金不存在董事会前投入的情况。

（二）本次募投项目具体建设内容和投资构成

1、设备购置及安装费用

本项目根据产能需要和建设规模，拟引进国内、国际先进设备共计 804 台/

套，设备购置及安装费用估算为 71,000 万元，具体如下表所示：

单位：万元

序号	工序	设备名称	单价	数量（台/套）	总价
1	图形	化学清洗机	100	10	1,000
2	图形	湿膜滚涂机	152	10	1,520
3	图形	激光直接成像机	545	13	7,085
4	图形	刷板机	160	3	480
5	图形	前处理机	100	3	300
6	图形	粘尘机（贴膜前）	10	3	30
7	图形	自动贴膜机	150	3	450
8	图形	垂直显影机	180	1	180
9	蚀刻	酸性蚀刻机	460	9	4,140
10	蚀刻	自动撕膜机	75	3	225
11	蚀刻	在线自动光学检查机	175	10	1,750
12	蚀刻	碱性蚀刻机	380	1	380
13	层准	冲孔机	160	7	1,120
14	层准	棕化机	160	7	1,120
15	层准	PP 钻孔机	40	1	40
16	层准	双层热融合机	96	11	1,056
17	层压	真空层压机（12 热 6 冷）	1,860	1	1,860
18	层压	真空层压机（6 热 2 冷）	800	1	800
19	层压	真空泵	15	20	300
20	层压	钢板刷板机	95	3	285
21	层压	钢板研磨机	45	3	135
22	层压	钢板暂存库	20	8	160
23	层压	工具板暂存库	20	15	300
24	层压	工具板暂存架	20	5	100
25	层压	回流机	700	1	700
26	层压	工具板	1,000	1	1,000
27	层压	钢板	1,300	1	1,300
28	铣边	X-RAY 钻靶机	81	3	243
29	铣边	裁磨机	330	3	990
30	铣边	裁磨清洗机	56	2	112

序号	工序	设备名称	单价	数量（台/套）	总价
31	钻孔	X-RAY 二次元测量仪	98	1	98
32	钻孔	数控铣床	55	22	1,210
33	钻孔	数控钻机	60	90	5,400
34	钻孔	数控钻机	90	27	2,430
35	钻孔	孔位检查机	60	2	120
36	钻孔	钻头研磨机（>0.4-1.2mm）	50	2	100
37	钻孔	钻头研磨机（≤0.4mm）	50	6	300
38	钻孔	X-ray 检查机	80	2	160
39	孔化	去毛刺机	230	2	460
40	孔化	水平去钻污清洗机	266	1	266
41	孔化	水平去钻污沉铜连线机	527	3	1,581
42	电镀	电镀机	930	5	4,650
43	电镀	电镀机	998	1	998
44	塞孔	铲平机	115	6	690
45	塞孔	重型刷板机	230	2	460
46	塞孔	塞孔机	138	8	1,104
47	塞孔	双轴陶瓷刷板机	60	2	120
48	塞孔	检修站	30	2	60
49	检验	检修站	36	4	144
50	检验	补线机	2	1	2
51	阻焊	网版涂布机	13	1	13
52	阻焊	网版烘箱	5	2	10
53	阻焊	网版光刻机	65	1	65
54	阻焊	网版显影机	15	1	15
55	阻焊	网版清洗机	17	1	17
56	阻焊	网版脱膜机	2	1	2
57	阻焊	刮刀研磨机	15	1	15
58	阻焊	油墨震荡机	3	2	6
59	阻焊	隧道烘箱	70	1	70
60	阻焊	火山灰磨板机	180	3	540
61	阻焊	塞孔机	118	3	354
62	阻焊	预烘烤箱	90	2	180
63	阻焊	直接成像机	620	4	2,480

序号	工序	设备名称	单价	数量（台/套）	总价
64	阻焊	阻焊显影机	230	2	460
65	阻焊	字符喷墨打印机	550	2	1,100
66	阻焊	隧道烘箱	100	1	100
67	阻焊	隧道烘箱（塞孔后固化）	230	1	230
68	物理室	回流焊	20	3	60
69	化金	化金前处理机	200	1	200
70	化金	化学镍金机	300	2	600
71	化金	化金后处理机	45	1	45
72	化金	X-ray 荧光测厚仪	99	1	99
73	OSP	抗氧化机	130	1	130
74	表面处理	成品清洗机	61	1	61
75	外形	瞬检机	95	1	95
76	外形	外形成品清洗机	86	2	172
77	电测试	A5 四密自动测试机	240	6	1,440
78	电测试	高速飞针测试机	260	3	780
79	电测试	数控双轴钻机	34	8	272
80	电测试	数控钻铣一体机	45	2	90
81	电测试	耐压测试机	55	1	55
82	电测试	大面积短路测试仪	11	1	11
83	成品检验	外观检查机	185	4	740
84	成品检验	UV 光源固化机	3	8	24
85	成品检验	AVI 水平自动线	13	8	104
86	成品检验	水平反直机	80	1	80
87	成品检验	板弯板翘检查机	39	1	39
88	成品检验	水平红外烘烤机	25	1	25
89	IPQC	自动阻抗测试机	325	1	325
90	物理室	金相显微镜	14	6	84
91	物理室	取样机	5	2	10
92	物理室	锡炉	1	2	2
93	物理室	PCB 镀层测试机	9	1	9
94	物理室	离子污染测试仪	30	1	30
95	物理室	TMA 树脂固化测试仪	39	1	39
96	物理室	耐电压测试仪	1	3	3

序号	工序	设备名称	单价	数量（台/套）	总价
97	物理室	恒温恒湿试验箱	12	1	12
98	物理室	冷热冲击箱	26	1	26
99	物理室	锡炉	3	2	6
100	物理室	X-RYA 测试仪	120	1	120
101	化验室	自动滴定进样器	72	1	72
102	化验室	AA 原子光谱分析仪	13	1	13
103	化验室	紫外分光光度计	5	1	5
104	包装	多功能自动包装机	600	1	600
105	包装	缠绕膜机	6	1	6
106	计量	铜厚测量仪	3	4	12
107	计量	光能量计	3	1	3
108	计量	空气阻力棒	1	4	4
109	计量	电子分析天平	1	2	2
110	计量	体积表面电阻率测试仪	1	1	1
111	仓库	迷你托盘叉车	2	3	6
112	仓库	物料出库配送升降机	40	1	40
113	仓库	站驾式电动堆垛叉车	9	1	9
114	钻孔	冻水机	200	1	200
115	层压	冻水机	80	1	80
116	-	自动化设备	28	321	8,988
合计				804	71,000

2、建筑及安装工程费用

本项目建筑及安装工程费用估算为 46,000 万元，具体如下表所示：

建筑名称	内容	金额（万元）
生产厂房	土建	12,000
	机电安装工程	19,950
	小计	31,950
物流中心	土建	3,319
	机电安装工程	1,775
	立体仓库建设及安装	5,000
	小计	10,094

建筑名称	内容	金额（万元）
员工宿舍楼	土建	2,806
	工程安装及家具采购	1,150
	小计	3,956
合计		46,000

3、铺底流动资金

铺底流动资金系为保证项目建成后运转所必需的流动资金，通常用于购买原材料、燃料、支付工资福利和其他经费等。本次募投项目的铺底流动资金为项目计算期流动资金需求额的 30%，其中流动资金需求额为流动资产（应收账款、存货、现金等）需求额与流动负债（应付账款）需求额之差计算而来，具体测算明细如下表所示：

项目	达产期（万元）				
	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
流动资产需求额①	45,228	45,307	44,999	44,697	44,403
流动负债需求额②	20,046	20,046	19,848	19,651	19,457
流动资金需求额③ =①－②	25,182	25,261	25,151	25,046	24,947
铺底流动资金 =③*30%	7,555	7,578	7,545	7,514	7,484

依据上述测算，自达产期第二年的后续年份不再新增流动资金需求，故本次募投项目的铺底流动资金为 7,578 万元。

（三）本次募投项目投资规模的合理性分析

1、本次募投项目系结合公司所处行业及市场情况设计，具体投资规模及明细测算系依据相关文件编制

本次募投项目系公司根据印制电路板生产制造特点，结合设备、工程等市场情况和公司扩产需求进行的项目设计和投资测算，具有合理性。本次募投项目根据国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及《投资项目可行性研究指南（试用版）》进行测算，具体费用结合本项目拟建工程的建设内容及工程量、建筑材料及设备的现行价格、当地类似工程造价指标

进行估算。

2、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的投入产出比相近

本次募投项目与公司现有业务及前次募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目”（以下简称“数通一期项目”）的固定资产投入产出比的对比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年末固定资产原值	2018 年度主营业务收入	投入产出比
公司现有业务	523,945.33	735,014.90	1.40
项目	固定资产投资规模	预计项目达产期平均年收入	投入产出比
数通一期项目	65,100	82,484	1.27
数通二期项目	117,000	151,076	1.29

注 1：投入产出比=收入/固定资产规模；

注 2：2019 年 1-6 月，数通一期项目已实现的营业收入为 50,509.03 万元，预计全年能够实现上表所述收入水平。

如上表所示，数通二期项目的固定资产投入产出比为 1.29，略低于公司现有业务的实际比值 1.40，主要原因系本次募投项目所使用生产设备、产线的生产效率和水平高于公司现有生产设备、产线的整体水平，固定资产价格相对较高；同时，公司现有产品类别众多，本项目预测达产后销售单价与公司现有产品平均单价相比有所下降，较为谨慎。本次募投项目与数通一期项目的投入产出比较为接近。

综上所述，本次募投项目系结合公司所处行业及市场情况设计，具体投资规模及明细测算系依据国家相关部门发布的有关文件编制，与公司现有业务及前次募投项目数通一期的固定资产投入产出比较为接近，本次募投项目的投资规模具有合理性。

二、说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排。

本次募投项目的投资总额为 124,578 万元，其中建设投资为 117,000 万元，拟以募集资金投入 106,400 万元，具体投资计划如下表所示：

单位：万元

工程项目	第一年	第二年	合计	拟以募集资金投入
------	-----	-----	----	----------

设备购置及安装费用	51,000	20,000	71,000	106,400
建筑及安装工程费用	46,000	-	46,000	
合计	97,000	20,000	117,000	106,400

公司于本次董事会决议日（2019年4月8日）后开始本项目建设投入，将在本次募集资金到位后将优先置换本次发行董事会后投入的资本性支出，并根据上表投资计划进行后续投入。

本次募投项目的建设期为2年，具体建设进度安排如下：

序号	工作内容	第一年						第二年					
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期工作	△											
2	初步设计、施工图设计、非标设备设计		△	△									
3	建筑及安装工程		△	△	△	△	△						
4	设备购置			△	△	△	△	△	△				
5	设备到货检验							△	△	△			
6	设备安装、调试								△	△	△	△	
7	职工培训								△	△	△	△	
8	试运行												△

三、说明本次募投项目与公司现有业务及前次募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目”的联系与区别，说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性，结合现有产能利用率、产销率等说明新增产能的消化措施

（一）本次募投项目与公司现有业务及数通一期项目的联系与区别

公司现有业务包括印制电路板业务、封装基板业务及电子装联业务，本次募投项目数通二期项目及前次募投项目数通一期项目均为公司现有印制电路板业务在通信应用领域的产能扩张和产品升级。现就本次募投项目数通二期项目与数通一期项目及公司现有印制电路板业务对比如下：

项目	数通二期项目	数通一期项目	公司现有印制电路板业务
主要产品及	中高端通信及服务器	普通通信及服务器	产品应用以通信领域为主，

应用领域	用高速高密度多层印制电路板	用高速高密度多层印制电路板	并重点布局工控医疗和航空航天等领域
生产能力	58 万平方米/年	34 万平方米/年	187 万平方米/年
产品特点	层数较高，平均层数达 16 层；使用的多为高速材料，产品具有高密度、大容量等特点	层数较低，平均层数为 8 层；使用的多为普通材料（如 FR-4 等级材料）	产品类型多样，印制电路板产品平均层数为 14 层

深南电路现有印制电路板业务以通信应用领域为主。为满足全球移动通信市场发展、下游客户需求及自身产业升级需要，公司自 2017 年开始实施“数通通用高速高密度多层印制电路板投资项目”，并根据通信市场状况分期投资。其中，数通一期项目主要面向普通通信及服务器领域，新增产能 34 万平方米/年；数通二期项目主要面向中高端通信及服务存储领域，新增产能 58 万平方米/年。

从应用领域来看，数通一期项目和数通二期项目的通信类产品均应用于通信基站，但实现的功能有所差别；而数通二期项目服务器类产品与数通一期项目相比则更多应用于中高端服务器领域。从产品技术特性来看，本次募投项目主要产品与数通一期项目在技术上具有延续性，但产品层数相对较高，多使用高速材料，产品具有高密度、大容量等特性。

本次募投项目将引进部分新型的生产设备及配套系统，同时改良部分生产工艺，以满足数通二期项目高密度、大容量产品的技术要求。

综上，数通二期项目是公司为进一步巩固自身通信领域领先地位的战略性选择，在产品用途、生产工艺、技术、原材料等方面对现有产品、技术进行拓展和优化，与数通一期项目和现有印制电路板业务不存在产能替代关系。

（二）本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性

1、项目建设的必要性、合理性分析

（1）公司现有产能及装备水平难以满足下游客户的发展需要

报告期内，公司印制电路板产品的产能、产量及销量情况如下：

产品类别	项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
印制电路板	产能（平方米）	990,000	1,870,000	1,440,000	1,344,000

	产量（平方米）	958,731	1,841,840	1,454,794	1,310,995
	产能利用率	96.84%	98.49%	101.03%	97.54%
	销量（平方米）	1,004,589	1,742,090	1,403,000	1,221,362
	产销率	104.78%	94.58%	96.44%	93.16%

报告期内，公司印制电路板业务的产能利用率分别为 97.54%、101.03%、98.49%和 96.84%，已趋于饱和。面对 5G 产业和服务器领域开启的新一轮发展机遇，公司亟待落实先进产能以适应下游技术发展、满足客户需求。

此外，公司目前用于加工高速高密度系统板的专用设备、可靠性检测设备和配套基础设施尚有不足，无法完全适应相关制造技术要求，制约了工艺技术的开发与提升，难以满足国内外客户对数通用印制电路板的技术需求。

因此，公司有必要进行数通二期项目建设，以提升印制电路板的制造技术能力并扩大产能，快速进入产业化阶段，满足下游市场日益增长的需求。

（2）公司产业升级的需要

近年来，制造业竞争日益激烈，信息化制造将成为未来企业立足之根本。在数通一期项目建设与运营经验的基础上，公司将通过本次募投项目的实施进一步对产品的生产工艺、生产流程进行优化，提升工厂信息化水平，推动现有产品结构调整，向专业化工厂转型，提升整体运营效率，进而全面提升市场竞争力。

2、项目可行性分析及产能消化措施

（1）不断扩大的市场规模为项目开展提供重要保障

数通用高速高密度多层印制电路板是移动通信系统中最为核心的关键元器件之一，承载着数据的交换、传输、运算及存储等功能，广泛应用于路由器、交换机、光传送网和数据中心的服务器、存储器等数通设备，属于高端 PCB 产品。

随着 5G 网络大规模建设的推进，数通用高速高密度多层印制电路板在通信设备领域的市场需求将不断提高。据 Prismark 统计，受数据中心的扩张和 5G 基础设施建设的驱动，预计 2019 年通信基础设施市场将增长 5.6%。5G 时代信息传输速度及传输容量明显提升，将带动数通用高速高密度多层印制电路板需求快速增长。

在 5G 网络不断完善的基础上，边缘计算等技术也有望得到进一步发展，数通用高速高密度多层印制电路板在服务器市场将获得结构性成长机会。据 Prismark 预测，2019 年服务器（含数据存储）市场规模将增长 7.7%。在下游市场稳定、快速发展的情况下，服务器用 PCB 的产销量将进一步提高。

（2）公司雄厚的技术研发实力和先进的工艺技术水平将为项目开展提供充足的技术储备

公司系中国印制电路行业的龙头企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司在高多层及普通高密度印制电路板等领域拥有多项国家专利，在特性阻抗控制技术、高频混压技术、高厚径比深度能力研究技术、HDI 技术、埋入式元器件技术以及散热金属基板制造技术等核心技术方面拥有多项首创性研究成果，多项产品被列入国家、广东省重点新产品计划，并多次获得广东省及深圳市科技进步奖。

公司始终以市场为导向开展自主创新，已积累了先进的核心技术和工艺水平，具有丰富的科技成果产业化能力和经验。5G 网络对数据运算量及传输速率的需求将对 PCB 加工工艺提出更高的要求，公司在通信领域雄厚的技术储备与研发实力将为本次募投项目的开展提供重要保障。

（3）公司客户资源丰富且已提前储备部分订单资源

本次募投项目的 PCB 产品主要应用于通信及服务器领域。通过多年不断努力，公司积累了众多优质的客户资源，已成为大批全球领先企业的主力供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。针对通信领域，公司已引入华为、诺基亚、中兴等全球领先的通信企业；针对服务器领域，公司亦已引入惠普、华为、联想等客户。

目前，公司已提前储备了部分订单资源，并导入了客户多个新料号产品，但受制于公司现有产能瓶颈，目前部分客户的产品订单尚未转化为大批量订单，该部分订单系数通二期项目产能消化的重要资源储备。

此外，公司将不断加强市场开拓力度，在保证国内业务稳步增长的同时，进一步加大对北美、欧洲等地区的开发，提升公司对各大区域市场的影响力及服

务覆盖。

四、说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性，本次募投项目在生产经营中能否与原有业务进行有效区分并做到独立核算

（一）数通二期项目收益情况

本次募投项目建成达产后的主要经济效益指标如下表所示：

序号	指标	数值
1	达产年平均营业收入（万元）	151,076
2	达产年平均利润总额（万元）	29,869
3	达产年平均毛利额（万元）	44,903
4	内部收益率（IRR）	11.11%
5	静态投资回收期（含建设期）	7.19 年

（二）测算过程和测算依据

1、营业收入测算

本项目主要以销定产，在测算销售收入时，视产量为销量。本项目建成后将新增印制电路板产能 58 万平方米/年，预计达产年新增销售收入及产品平均销售价格的测算情况如下表所示：

收入单位：万元，售价单位：元/平方米

项目	达产年				
	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
销售收入	152,880	152,880	151,367	149,868	148,384
平均销售价格	2,636	2,636	2,610	2,584	2,558

上述产品的平均销售价格系公司根据目前市场现状，结合目前同类已销售产品售价及对未来市场发展的预期综合考虑后确定的预估售价。预估售价已考虑了可能面临的市场竞争等因素，并假定在达产期呈现先增后降的趋势，预估价格谨慎合理。

2、产品成本及费用测算

（1）各项费用以达产年为依据进行叙述，并且根据市场行情预测。

(2) 本项目最终产品为多层印制电路板。根据产品的消耗量及市场价进行测算，其中主要材料单价按市场价格计算。

(3) 直接动力费用及其他根据业务性质分别计算，包括电费、水费、燃气费、蒸汽费及其他相关费用；根据历史情况，按照营业收入 11%测算。

(4) 直接工资及福利根据公司现行工资标准及人员安排计划为依据进行计算，生产人员 10 万元/人/年，管理及技术人员 13 万元/人/年，达产后以一线员工按 4%，管理及技术人员按 5%的年复合增长率递增。

(5) 固定资产折旧费按平均年限法计算，其中：机器设备按 10 年折旧、生产厂房按 35 年折旧。

(6) 修理费及其他：含大修理费及备品备件费用，按折旧费的 30%测算。

(7) 研发费用按照营业收入 4%测算。

(8) 销售费用按营业收入的 2%测算；包括公司销售产品过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本公司产品而专设的销售机构的职工工资及福利费等费用。

(9) 总成本费用包括生产成本及期间费用，其中生产成本包括原材料成本、直接动力费、直接工资及福利、制造费用，期间费用包括管理费用、财务费用及销售费用。

(10) 经营成本是项目生产经营阶段发生的成本，是总成本费用扣除折旧费、摊销费、财务费用后所得结果。

3、各项税费测算

本项目各项税、费按国家有关规定的税率和费率计算，增值税税率为 13%，城市维护建设税税率为 7%，教育费附加费率为 3%，企业所得税税率为 25%。

4、本项目产品毛利率水平分析

最近三年一期，公司与同行业可比上市公司的毛利率对比情况如下所示：

公司名称	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
------	--------------	---------	---------	---------

公司名称	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
鹏鼎控股	19.95%	23.19%	17.89%	16.61%
奥士康	-	23.94%	24.02%	29.58%
明阳电路	29.30%	28.75%	31.27%	34.57%
依顿电子	28.80%	30.55%	33.37%	28.57%
沪电股份	-	23.41%	17.94%	15.67%
景旺电子	28.52%	31.78%	32.51%	32.26%
崇达技术	31.76%	32.94%	32.61%	36.81%
博敏电子	21.09%	18.78%	17.53%	16.84%
胜宏科技	-	27.56%	25.97%	27.32%
兴森科技	31.29%	29.56%	29.30%	30.66%
世运电路	24.90%	22.73%	22.06%	29.49%
广东骏亚	-	20.43%	17.64%	19.94%
弘信电子	-	11.64%	12.62%	14.00%
平均值	26.95%	25.02%	24.21%	25.56%

数据来源：上市公司公告

注：截至本反馈意见回复签署之日，奥士康等 5 家上市公司尚未公布 2019 年 1-6 月经营数据。

本项目建成后达产年产品的平均毛利率为 29.72%，高于同行业上市公司平均水平，主要原因在于本项目进一步优化生产工艺及流程，大幅提升了信息化、自动化水平，提升成本管控能力，整体运营效率将有较大幅度提升。此外，本项目毛利率亦高于数通一期项目 2019 年 1-6 月的毛利率水平 26.30%，主要系本项目主要产品相较于数通一期项目的技术含量更高、产品价格亦相对较高。

5、项目收益的合理性

本项目的收入、各项税金、成本费用等测算考虑了印制电路板行业的市场特征，同时依据公司过往项目的历史数据，贴合了发行人的实际情况。本项目建成达产后，销售毛利率指标略高于现有水平，主要系本项目整体运营效率较高所致。因此，本次募投项目的测算是谨慎合理的。

（三）本次募投项目在生产经营中能与原有业务进行有效区分并做到独立核算

本次募投项目的主要生产场所及配套工程均为新建设施，能够在独立物理

空间内实施。项目建成后，本次募投项目的生产均在新建厂房内进行，配备独立车间人员，并划分独立区域用于原辅材料、库存商品的存放和收发管理；新建厂房将独立安装水电气计量表，生产过程中耗用的水电气等将独立计量与核算。因此，本次募投项目能够保证与原有业务进行有效区分。

此外，本次募投项目将制定独立的项目收入、成本和费用的核算体系，单独设置财务账套对项目进行独立核算，公司将为募投项目单独设立银行账户，能够有效监管募集资金的使用与核算，同时确保募投项目资金运转的独立，保证了本次募投项目的独立核算。

五、保荐机构核查情况

（一）核查方式

1、查阅发行人本次募投项目及前次募投项目的可行性研究报告，同时取得公司现有业务相关资料，并进行对比分析；

2、核查本次募投项目具体建设内容和投资构成、募集资金使用和项目建设的进度安排、截至董事会决议日前的进展和已投资金额、本次募投效益测算的情况及发行人制定的《募集资金管理制度》；

3、查阅发行人审计报告及财务资料、同行业上市公司公告等公开信息资料，取得公司现有产能利用率、产销率相关资料，同时与发行人管理人员进行了访谈，对本次募集资金投资项目达产后产能消化的具体措施进行了核查。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目投资金额的测算依据、过程和结果考虑了行业发展情况、发行人自身经营情况和行业地位，投资规模具有合理性。截至本次发行董事会召开时点，发行人尚未投入建设。

2、本次募集资金到位后，发行人将优先置换本次发行董事会决议日后已投入的资本性支出部分，并根据具体投资计划进行后续投入，本次募投项目的建设进度及募集资金使用计划安排具有合理性。

3、本次募投项目系发行人紧抓 5G 产业发展机遇，在现有业务基础上，不断满足市场日益增长的需求和深化公司业务布局的重要举措，本次募投项目建设具有必要性、合理性及可行性，公司具备相应的措施消化新增产能。

4、本次募投项目的效益测算符合公司业务的实际情况，效益测算方法、测算过程及测算依据谨慎合理。本次募投项目的生产均在新建厂房内进行，与原有业务在生产过程、成本核算、人员管理等方面能够有效区分并独立核算。

2、申请人前次募投项目中，“数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资者项目”截至 2018 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态，项目实施达产后预计年均可实现净利润 10,774 万元，“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”达到预定可使用状态的日期由 2018 年 12 月 31 日调整到 2019 年 6 月 30 日。请申请人：（1）说明“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”延期的具体原因，是否及时履行了决策程序和信息披露义务，是否积极采取措施加以补救；（2）说明尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排；（3）说明前次募集资金投资项目实际效益是否达到预期并说明原因。请保荐机构及会计师核查并发表意见。

回复：

一、说明“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”延期的具体原因，是否及时履行了决策程序和信息披露义务，是否积极采取措施加以补救

（一）延期的具体原因及公司采取的措施

公司“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”计划投入募集资金 54,831.16 万元，已于 2017 年 1 月开工，原计划建设期为 2 年，预计于 2018 年 12 月 31 日达到预计可使用状态。基于市场和外部宏观环境的变化，为匹配客户的产能建设、产品投放进度，保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益和需求，公司对该项目的实施进度进行调整，项目达到预计可使用状态的时间由“2018 年 12 月 31 日”调整至“2019 年 6 月 30 日”。

针对公司募投项目建设延期的情形，一方面，公司持续跟踪市场和外部宏观环境，加大客户开发和市场开拓力度；另一方面，公司积极推进项目后期建设、

装修、生产工艺流程优化和机器设备采购、安装等相关工作。截至 2019 年 6 月 30 日，“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”已开始连线试生产。

（二）履行的决策程序和信息披露义务

2019 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”达到预定可使用状态的日期由 2018 年 12 月 31 日调整到 2019 年 6 月 30 日，项目的其他内容均保持不变。针对该事项，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

公司已于 2019 年 3 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）对上述募集资金实施进度调整事项及时履行了信息披露义务，具体公告文件如下：

序号	公告名称	公告编号
1	《深南电路股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》	2019-023
2	《深南电路股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》	2019-016
3	《深南电路股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》	2019-017
4	《深南电路股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》	-
5	《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》	-

二、说明尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排

截至 2019 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金	截至 2019 年 6 月 30 日已投入金额
1	半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	无锡深南	101,533	54,831.16	56,221.16
2	数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目	南通深南	73,074	45,000.00	45,286.11
3	补充流动资金	深南电路	-	26,932.11	26,998.74
合计				126,763.27	128,506.01

注：上表中的募投项目累计投入金额多于拟使用募集资金金额，主要系募集资金专户的

利息收入及闲置募集资金理财收益用于募投项目的支出所致。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司已累计投入前次募集资金 128,506.01 万元(含募集资金专户的利息收入及闲置募集资金理财收益 1,742.74 万元),募集资金专项账户余额为零,前次募集资金已使用完毕。

三、说明前次募集资金投资项目实际效益是否达到预期并说明原因

截至 2019 年 6 月 30 日,公司前次募集资金投资项目产生的经济效益情况如下所示:

单位:万元

实际投资项目		项目达到预定可使用状态日期	承诺效益	截至 2019 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	2019 年 6 月 30 日	19,340.00	-	不适用
2	数通用高速高密度多层印制电路板(一期)投资项目	2018 年 12 月 31 日	10,774.00	4,923.02	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用

公司数通一期项目于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态,并于 2019 年 1-6 月累计实现效益 4,923.02 万元,预计 2019 年全年该项目将实现预计承诺效益;截至 2019 年 6 月 30 日,半导体高端高密 IC 载板产品制造项目已开始连线试生产,尚未产生测算效益。

四、保荐机构和会计师核查情况

(一) 核查方式

1、查阅了与“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”延期的相关公告和决策文件;

2、取得公司截至 2019 年 6 月 30 日关于前次募集资金使用情况的报告及资金流水,抽查前次募投项目资产设备购建合同及支付凭据,实地走访了解前次募投项目的建设情况,并与公司相关管理人员进行了访谈。

(二) 保荐机构和会计师核查意见

经核查,保荐机构和会计师认为:公司基于市场和外部宏观环境的变化,为

匹配客户的产能建设、产品投放进度，保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益和需求，对“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”的实施进度进行调整，公司已履行必要的决策程序和信息披露义务。截至 2019 年 6 月 30 日，公司前次募集资金均已使用完毕。2019 年 1-6 月，数通一期项目已累计实现效益 4,923.02 万元，预计 2019 年全年将实现预计效益；截至 2019 年 6 月 30 日，“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”已开始连线试生产，报告期内尚未产生测算效益。

3、请申请人：（1）说明报告期至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况，并结合公司主营业务，说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务，下同）情形，同时结合最近一期末货币资金的构成及主要预计用途，并对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性；（2）结合公司是否投资产业并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况，说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形。请保荐机构及会计师核查并发表意见。

回复：

一、说明报告期至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况，并结合公司主营业务，说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务，下同）情形，同时结合最近一期末货币资金的构成及主要预计用途，并对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性

（一）公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况

根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

根据中国证监会《关于上市公司监管指引第2号——有关财务性投资认定的问答》，财务性投资除持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：1、上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；2、上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

根据《再融资业务若干问题解答》，财务性投资包括但不限于：设立或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

1、公司不存在实施或拟实施的财务性投资

按照上述法规的规定，报告期至本反馈意见回复签署之日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资，具体情况如下：

（1）交易性金融资产

报告期至本反馈意见回复签署之日，公司不存在持有交易性金融资产的情形。

（2）借予他人款项

报告期至本反馈意见回复签署之日，公司不存在借予他人款项的情形。

（3）可供出售金融资产/其他权益工具投资

报告期各期末，公司持有的可供出售金融资产/其他权益工具投资的账面价值如下：

单位：万元

项目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
可供出售金融资产	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
其他权益工具投资	2,286.13	-	-	-

注：2019年，公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司可供出售金融资产账面价值均为 1,500.00 万元，系公司对华进半导体的股权投资。2019 年 6 月末，公司其他权益工具投资账面价值为 2,286.13 万元，其中对华进半导体的投资账面价值为 1,986.13 万元，对汇芯通信的投资账面价值为 300 万元。报告期至本反馈意见回复签署之日，公司仅新增对汇芯通信的股权投资。截至本反馈意见回复签署之日，公司持有华进半导体 6.40%的股权，持有汇芯通信 3.00%的股权，其基本情况如下：

1) 华进半导体

公司名称	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	
成立时间	2012 年 9 月 29 日	
注册资本	23,445 万元	
法定代表人	曹立强	
公司类型	有限责任公司	
注册地址	无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D1 栋	
经营范围	集成电路封装与系统集成的技术研发；半导体集成电路和系统集成产品的技术转让、技术服务及产品销售；行业性实业投资；自营各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股东构成及持股比例	国开发展基金有限公司	21.33%
	中国科学院微电子研究所	11.66%
	曹立强	9.00%
	江苏长电科技股份有限公司	8.53%
	通富微电子股份有限公司	8.53%
	天水华天科技股份有限公司	8.53%
	苏州晶方半导体科技股份有限公司	8.53%
	安捷利电子科技（苏州）有限公司	6.40%
	深南电路	6.40%
	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	6.82%
	江苏中科物联网科技创业投资有限公司	4.27%

华进半导体的主营业务为集成电路封装与系统集成的技术研发，服务范围包括设计仿真、先进封装技术及测试服务，与公司封装基板业务同属集成电路领域，本次投资有利于公司接触行业前沿技术并加强与同行业交流合作，在业务上发挥

战略协同效应。

2) 汇芯通信

公司名称	深圳市汇芯通信技术有限公司	
成立时间	2019 年 3 月 29 日	
注册资本	20,000 万元	
法定代表人	曾学忠	
公司类型	有限责任公司	
注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2701	
经营范围	一般经营项目是：集成电路设计、研发、销售、技术服务；微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的开发、销售、技术服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；从事货物及技术进出口；高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理；电子产品的检验检测服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：集成电路生产；微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的生产。	
股东构成及持股比例	深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙）	24.00%
	深圳市福田投资控股有限公司	16.00%
	深圳市南科大资产经营管理有限公司	10.00%
	力合科创集团有限公司	10.00%
	深圳国人通信股份有限公司	3.00%
	深南电路股份有限公司	3.00%
	广州市众拓光电科技有限公司	2.50%
	天津京信通信系统有限公司	2.00%
	日海智能科技股份有限公司	2.00%
	深圳金信诺高新技术股份有限公司	2.00%
	创未控股（深圳）有限公司	2.00%
	苏州晶湛半导体有限公司	2.00%
	山东天岳先进材料科技有限公司	2.00%
	深圳前海盛元投资有限公司	2.00%
	苏州能讯高能半导体有限公司	2.00%
	重庆南梦企业管理咨询有限公司	1.50%
	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	1.00%

	深圳基本半导体有限公司	1.00%
	广州慧智微电子有限公司	1.00%
	深圳科创新源新材料股份有限公司	1.00%
	博敏电子股份有限公司	1.00%
	深圳市天珑移动技术有限公司	1.00%
	广东通宇通讯股份有限公司	1.00%
	四川益丰电子科技有限公司	1.00%
	深圳市掌网科技股份有限公司	1.00%
	深圳市科信通信技术股份有限公司	1.00%
	厦门盈趣科技股份有限公司	1.00%
	深圳市展想信息技术有限公司	1.00%
	厦门晨智数字科技有限公司	1.00%
	武汉光谷创元电子有限公司	1.00%

汇芯通信系由深圳市福田区政府、清华大学、南方科技大学联合多家 5G 产业链上下游的龙头企业和上市公司发起成立，专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转化推广和首次商业化的高科技公司。汇芯通信已获批广东省 5G 中高频器件创新中心并成功发起组建了覆盖全国的 5G 产业技术联盟。公司对汇芯通信的投资有利于产业链的延伸和拓展。

公司对华进半导体和汇芯通信的投资系围绕主营业务及未来发展战略而进行的战略性投资，不以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

（4）委托理财

报告期至本反馈意见回复签署之日，公司的委托理财均系使用闲置募集资金购买的中国银行和农业银行发行的保本保收益型理财产品。报告期各期末，公司持有的理财产品余额如下：

单位：万元

项目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
委托理财	-	17,500.00	-	-

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设。公司对于暂时闲

置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财不属于《再融资业务若干问题解答》规定的“购买收益波动大且风险较高的金融产品”，旨在提高资金使用效率，不属于财务性投资。

（5）产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；投资金融业务

报告期至本反馈意见回复签署之日，公司不存在投资产业基金及并购基金的情形，不存在对外拆出资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形，不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品、投资金融业务的情形。

2、公司不存在实施或拟实施的类金融业务

报告期至本反馈意见回复签署之日，公司未实施类金融业务，目前亦无拟实施的类金融业务。

（二）公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形

报告期内，公司主要从事印制电路板产品、封装基板产品及电子装联产品的研发、生产及销售。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在持有交易性金融资产、借予他人款项以及委托理财的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司的其他权益工具投资金额为 2,286.13 万元，系公司对华进半导体和汇芯通信的股权投资。公司对该两家公司的投资系围绕主营业务及未来发展战略而进行的战略性投资，不以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在投资产业基金及并购基金的情形，不存在对外拆出资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形，不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品、投资金融业务或类金融

业务的情形。

综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

（三）本次募集资金量的必要性

1、最近一期末货币资金的主要构成及用途

截至 2019 年 6 月 30 日，公司持有的货币资金余额为 42,949.27 万元，具体构成如下：

项目	金额（万元）	占比
库存现金	6.35	0.01%
银行存款	42,467.69	98.88%
其他货币资金	475.23	1.11%
合计	42,949.27	100.00%
可自由支配的货币资金余额	42,474.27	98.89%

注：其他货币资金包含信用保证金 475 万元及支付宝企业账户余额 0.23 万元。

如上表所示，公司可自由支配的货币资金余额为 42,474.27 万元。公司具有较大的资金支出需求，该部分货币资金将用于公司日常经营、偿还银行借款、项目建设、未来年度现金分红等。

（1）公司日常经营性资金需求

公司所处的印制电路板制造行业属于资本和技术密集型产业，对资金投入的需求较高，且近年来公司业务保持较快增长，对营运资金的需求较大，公司需要保留一定数额的资金用于日常生产经营活动。

最近三年及一期，公司经营性现金支出情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营性现金支出	404,026.81	648,167.16	475,347.84	380,415.31
月均经营性现金支出	67,337.80	54,013.93	39,612.32	31,701.28
月均经营性现金流出增加额	13,323.87	14,401.61	7,911.04	-
月均经营性现金流出增加额平均值			11,878.84	-

注：经营性现金支出为公司当期经营活动现金流出小计；月均经营性现金流出增加额=本年月均经营性现金流出-上年月均经营性现金流出。

考虑业务日益增长且存货周转、销售回款存在一定周期，结合公司实际存货及应收账款周转情况，公司需保留不少于满足未来 4 个月资金支出的可动用货币资金余额。公司报告期内应收账款及存货周转天数情况如下：

单位：天

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
存货及应收账款周转天数	128.82	132.12	126.39	124.56
存货及应收账款平均周转天数	127.97			

最近三年及一期，公司业务快速发展，以月均经营性现金流出增加额平均值 11,878.84 万元测算，预计未来一年需新增可动用货币资金 47,515.37 万元。

（2）偿还银行借款需求

截至 2019 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 6,874.70 万元，一年内到期的长期借款余额为 63,026.95 万元，合计 69,901.65 万元。为保障公司短期偿债能力，公司需要为一年内到期的银行借款预留一定的资金。

（3）购建固定资产、无形资产等资本性支出需求

最近三年及一期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 48,863.04 万元、53,207.08 万元、118,430.14 万元和 88,496.77 万元，合计金额为 308,997.03 万元，其中，除部分以 IPO 募集资金投入外，其余均使用自有资金或自筹资金。公司每年需保有一定的资金量满足正常的投资活动需求。

此外，本次募集资金投资项目“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）”计划投资总额为 124,578 万元，其中拟以募集资金投入 106,400 万元，资金缺口部分由公司自有资金解决。

（4）未来年度现金分红

根据《公司章程》的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计

划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

结合公司目前实现利润情况，公司需要保留足额的现金以满足现金分红的要求，维护股东权益。

综上所述，公司需要保有一定的资金量来维持日常营运、偿还银行借款、满足购建固定资产、无形资产等资本性投资需求以及准备未来年度现金分红，目前可自由支配的货币资金不足以满足公司未来的资金需求，本次募集资金量具有必要性。

2、目前财务性投资总额、本次募集资金规模和公司净资产水平的情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司归属于母公司所有者权益合计 400,527.13 万元，本次募集资金总额不超过 152,000.00 万元，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形，财务性投资占本次募集资金规模和公司净资产水平的比例均为 0。

综上所述，公司需要保有一定的货币资金来维持日常运营、偿还银行借款以及满足构建固定资产和无形资产等资本性支出需求。最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形。本次募集资金投资项目的投资规模与公司业务发展、财务状况、市场需求等相匹配，本次募集资金具有必要性。

二、结合公司是否投资产业并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况，说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形

报告期至本反馈意见回复签署之日，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形，也不存在控制该类基金并应将其纳入合并报表范围的情形。

三、保荐机构和会计师核查情况

（一）核查方式

1、查阅了报告期内发行人的审计报告、财务报告；

2、查阅了报告期内交易性金融资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他流动资产、其他应收款的明细表；

3、取得了发行人报告期内购买的理财产品清单以及相应的理财产品合同；

4、查阅了发行人对外投资的投资协议以及内部决策文件；

5、查阅了发行人报告期内的资本性支出明细表；

6、访谈发行人的董事会秘书、财务负责人，了解发行人已实施的对外投资情况以及短期内可预见的资金需求情况。

（二）保荐机构和会计师核查意见

经核查，保荐机构和会计师认为：报告期至本反馈意见回复签署之日，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形；最近一期末，发行人不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形；随着经营规模的不断扩大，发行人需要保有一定的货币资金来维持日常运营、偿还银行借款、满足构建固定资产和无形资产等资本性支出需求以及准备未来年度现金分红；本次募集资金投资项目的投资规模与发行人业务发展、财务状况、市场需求等相匹配，本次募集资金量具有必要性；报告期至本反馈意见回复签署之日，发行人不存在投资产业基金、并购基金的情形，也不存在控制该类基金并应将其纳入合并报表范围的情形。

4、请在募集说明书“重大事项提示”部分，结合可转债的品种特点、转债票面利率与可比公司债券的利率差异、转股价格与正股价格的差异等，充分提示可转债价格波动甚至低于面值的风险。

回复：

发行人已在《募集说明书》“重大事项提示”之“六、公司的相关风险”之“（六）可转换公司债券本身的风险”和“第三节 风险因素”中补充披露可转债价格波动甚至低于面值的风险，具体如下：

“6、可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债在上市交易、转股等过程中，受宏观经济形势、公司经营业绩及投

资者预期等多种不确定性因素影响，价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者面临较大的投资风险。

与普通公司债券不同，可转债持有人有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为上市公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比同期限和评级的可比公司债券的利率更低。投资者持有可转债的利息收入可能低于持有可比公司债券享有的利息收入。

可转债的交易价格会受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能出现公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以及可转债特殊的产品特性，以便作出正确的投资决策。”

5、根据申请材料，2018年3月19日，深圳证券交易所出具的《关于对深南电路股份有限公司的监管函》，载明：“公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的附属企业中国航空技术深圳有限公司非经营性资金占用余额为300万元。”“公司实际控制人中国航空工业集团有限公司违反了其在《控股股东、实际控制人声明及承诺》中作出的承诺。”请申请人结合上述情况补充披露：（1）《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的主要内容；（2）上述情形的形成原因及整改情况，公司内控是否健全并有效执行；（3）上述情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十一条第（四）款的情形，是否构成本次发行的法律障碍；（4）除上述情形外，控股股东、实际控制人是否存在其他未履行相关承诺的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

回复：

发行人已在《募集说明书》“第四节 公司基本情况”之“十八、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况”之“（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况”补充披露以下内容：

一、《控股股东、实际控制人声明及承诺书》主要内容

2016年12月12日，公司控股股东中航国际控股、实际控制人航空工业集团分别出具《关于深南电路股份有限公司首次公开发行并上市事项的相关承诺》，就避免占用公司资金承诺如下：

“本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及规定，确保不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺，导致深南电路或其股东的权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股东/实际控制人期间，上述关于避免占用资金的承诺持续有效。”

二、上述情形的形成原因及整改情况，公司内控是否健全并有效执行

（一）形成原因及整改情况

为拓宽下属企业融资渠道，公司实际控制人航空工业集团于2009年集中发行企业债券，并将筹集的资金借予其下属企业。同时，为保证各参与企业到期按时偿付，航空工业集团于《企业债券资金使用协议》中约定，企业债券用款单位应按一定比例向航空工业集团缴存偿债折旧准备金。

该债券发行后，航空工业集团借予中航国际深圳，用于深南有限高密度印制电路板生产建设项目。2009年10月26日，中航国际深圳与深南有限签订《转贷协议》。根据航空工业集团企业债券发行及额度分配方案，中航国际深圳向深南电路转借10,000万元，借款期间为2009年10月27日至2019年10月26日，借款利率按《企业债券资金使用协议》执行。同时，深南电路向中航国际深圳缴存偿债折旧准备金300万元。

截至2017年末，因上述贷款尚未到期，故相关偿债折旧准备金未收回，形成中航国际深圳对上市公司非经营性资金占用余额300万元。2018年3月30日，中航国际深圳已向公司归还300万元偿债折旧准备金。

公司在收到有关监管文件后按照文件要求进行了认真核查和整改，对该笔

款项的背景情况及形成原因等进行了披露，中航国际深圳已及时归还该笔款项。同时，公司在以后的工作中将加强对相关规则及案例的学习与培训，规范相关流程，严格规范对关联方资金往来的管理，杜绝类似情况发生。

（二）公司内部控制健全并有效执行

报告期内，公司对基本制度与业务活动的内部控制均进行了梳理和完善，通过补充现有制度，固化规范标准的操作流程等方式，进一步完善了公司的内部控制体系。公司现有的主要内部控制制度及作用如下表所示：

层次	方面	制度
基本控制	公司治理及组织结构	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《部门内部架构及职员编制管理规定》等
	发展战略管理	《董事会战略委员会工作细则》
	人力资源管理	《人力资源规划制度》、《部门内部架构及职员编制管理规定》、《人员调动管理办法》、《内部招聘管理制度》等
	企业文化	《企业文化建设管理制度》
业务控制	资金活动管理	《现金管理制度》、《银行账户管理制度》、《融资管理制度》等
	存货管理	《管理库房原材料收料流程》、《管理库房发料流程》、《管理库存盘点流程》、《原材料仓管理规则》、《成品仓管理规则》、《包装配套流程》等
	固定资产管理	《设备采购流程》、《新设备安装、调试、验收及货款支付流程》、《设备大修、改造及验收流程》、《生产设备报废、处置流程》以及《固定资产管理制度汇编》等
	无形资产管理	《土地管理办法》、《企业识别系统（CIS）管理办法》、《专利管理制度》、《不动产管理制度》、《知识产权管理制度》等
	销售与收款管理	《市场细分流程》、《市场营销部业务操作手册》、《报价流程》、《客户信用管理制度》、《订单接收及处理规程》、《制定发货计划流程》、《应收账款管理流程》、《客户服务流程》、《客户投诉处理程序》等
	采购与付款管理	《采购控制程序》、《设备采购流程》、《服务采购管理制度》、《管理采购主协议&采购说明书规则》、《选择供应商流程》、《管理供应商绩效流程》、《采购招标管理制度》、《应付账款管理制度》等
	生产及质量管理	《安全教育培训制度》、《消防安全管理制度》、《生产安全事故报告和责任追究办法》、《安全生产责任制》、《安全检查与事故

	隐患治理制度》等
研究与开发管理	《新产品、新技术研发流程》、《专利申请及管理流程》《知识产权管理制度》、《技术档案管理制度》等
合同及法务管理	《合同管理制度》、《法律纠纷案件管理制度》、《档案管理制度汇编》等
工程项目管理	《基建管理制度汇编》、《基建项目安全管理制度》等
对外担保管理	《对外担保管理制度》
对外投资管理	《对外投资管理办法》
关联交易管理	《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
全面预算管理	《全面预算管理制度》
信息系统管理	《计算机信息系统管理办法》、《信息安全管理制度》、《ERP系统日常运行管理办法》、《ERP项目管理办法》等
对子公司的管控	《股权投资管理办法》

公司定期对内控制度及运行情况进行自我评价，并及时披露了相应的《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》等文件。报告期内，瑞华出具的《内部控制鉴证报告》及报告结论如下所示：

瑞华于 2019 年 5 月 15 日就公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》（瑞华核字 [2019] 01210039 号），其鉴证意见为：“我们认为，深南电路于 2019 年 3 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

瑞华于 2019 年 3 月 12 日就公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》（瑞华核字 [2019] 01210003 号），其鉴证意见为：“我们认为，深南电路于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

瑞华于 2017 年 9 月 20 日就公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》（瑞华核字 [2017] 48460017 号），其鉴证意见为：“我们认为，深南电路于 2017 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了按照财务部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”

瑞华于 2017 年 3 月 14 日就公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》（瑞华核字 [2017] 48460004 号），其鉴证意见为：“我们认为，深南电路于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财务部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”

综上，报告期内，公司内部控制健全，且得到了有效执行。

三、上述情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十一条第（四）款，是否构成本次发行法律障碍

如前所述，2018年3月30日，中航国际深圳已向深南电路归还了上述偿债折旧准备金。截至本反馈意见回复签署之日，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方对公司非经常性资金占用余额为零。故上述资金占用情形整改完成至公司做出本次可转债董事会决议时已超过十二个月，公司及控股股东或实际控制人在最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为。

综上，中航国际深圳对深南电路的相关资金占用情形整改完成已超过十二个月，公司及控股股东或实际控制人在最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，未违反《上市公司证券发行管理办法》第十一条第（四）款之规定，不构成本次发行的法律障碍。

四、控股股东、实际控制人是否存在其他未履行相关承诺

截至本反馈意见回复签署之日，公司控股股东、实际控制人不存在其他未履行相关承诺的行为，具体承诺履行情况如下表所示：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
航空工业集团	股份锁定及限售承诺	自深南电路股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的深南电路公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自深南电路股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司控制企业中航国际控股股份有限公司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如中航国际控股所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，中航国际控股持有深南电路股票的锁定期限自动延长六个月。	2017年11月20日	2017年12月13日至2020年12月12日	正在履行
中	股份	自深南电路股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人	2017年	2017	正

航 国 际 控 股	锁定及限售承诺	管理本公司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如本公司所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有深南电路股票的锁定期自动延长 6 个月。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	11 月 20 日	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	正在履行
中 航 国 际 控 股	股份减持承诺	本公司持有深南电路股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不丧失对深南电路控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，如本公司通过深圳证券交易所减持深南电路股份，累计减持数量不超过深南电路股本总数的 10%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2017 年 11 月 20 日	2017 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 12 日	正在履行
中 航 国 际 控 股	IPO 稳定股价承诺	深南电路上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如深南电路股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）。深南电路将在上述任一条件满足后 2 个交易日内向本公司发出应由本公司增持股份稳定股价的书面通知。本公司承诺：单次用于增持股份的资金金额不低于其自深南电路上市后累计从深南电路所获得现金分红金额（扣除之前已用于稳定股份的增持金额）的 10%，单一会计年度其用以稳定股价的增持资金合计不超过深南电路上一年度经审计的归母净利润的 40%。	2017 年 11 月 20 日	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	正在履行
航 空 工 业 集 团	填补被摊薄即期回报承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预深南电路经营管理活动，不侵占深南电路利益。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在履行
中 航 国 际 控 股	填补被摊薄即期回报承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预深南电路经营管理活动，不侵占深南电路利益。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在履行
航 空 工	避免同业竞争	1、除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与	2017 年 11 月 20 日	长期	正在履行

业集团	承诺	深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。			行
中航国际控股	避免同业竞争承诺	1、除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。在深南电路依法存续且本公司为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%以上股份的情况下，本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、在本公司仍然为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%以上股份的期间，若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。4、本公司确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺而给深南电路造成损失的，本公司同意对由此而给深南电路造成的损失予以赔偿。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在履行
航	减少	1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大	2017 年	长期	正

空 工 业 集 团	和规 范关 联交 易承 诺	影响的公司/个人与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不通过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。	11月20日		在履行
中航国际控股	减少和规范关联交易承诺	1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司/个人与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不通过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。	2017年11月20日	长期	正在履行
航空工业集团	避免占用资金的承诺	本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及规定,确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺,导致深南电路或其股东的权益受到损害,本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股东期间,上述关于避免占用资金的承诺持续有效。	2017年11月20日	长期	正在履行
中航国际控股	避免占用资金的承诺	本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及规定,确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺,导致深南电路或其股东的权益受到损害,本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2017年11月20日	长期	正在履行
航空工业集团	首次公开发行股票相关文件真实性、准	若监管部门认定深南电路招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律法规规定承担本公司应承担的民事赔偿责任,赔偿投资者损失。	2017年11月20日	长期	正在履行

	确性、完整性的承诺				
中航国际控股股	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	若深南电路本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断深南电路是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回已转让的原限售股份（如有）；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2017年11月20日	长期	正在履行
中航国际控股股	未履行承诺时相关约束措施的承诺	（一）如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在深南电路股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向深南电路股东和社会公众投资者道歉；（二）如果因本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给深南电路或者其他投资者造成损失的，本公司将向深南电路或者其他投资者依法承担赔偿责任；（三）如果本公司未承担前述赔偿责任，深南电路有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，同时，在本公司未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的深南电路股份；（四）如果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归深南电路所有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所获收益支付给深南电路指定账户；（五）在本公司作为深南电路控股股东期间，若深南电路未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本公司承诺依法承担赔偿责任。（六）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向深南电路的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、本公司公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。	2017年11月20日	长期	正在履行

五、保荐机构和发行人律师核查情况

（一）核查方式

1、获取了与资金占用事项相关的协议、资金往来凭证，了解资金占用形成

的背景及整改情况；

2、获取了公司相关内部控制制度、报告期内公司《内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》等文件，了解公司报告期内的内部控制制度执行情况；

3、获取了公司控股股东、实际控制人向投资者作出的公开承诺，查阅了发行人公开披露信息、检索了证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）及深交所网站“承诺事项及履行情况”（<http://www.szse.cn/disclosure/supervision/promise/index.html>）公示信息，了解公司控股股东、实际控制人向投资者作出的公开承诺的内容及履行情况。

（二）保荐机构和发行人律师核查意见

经核查，保荐机构和发行人律师认为：中航国际深圳对深南电路的相关资金占用情形整改完成已超过十二个月，公司及控股股东或实际控制人在最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，未违反《上市公司证券发行管理办法》第十一条第（四）款之规定，不构成本次发行的法律障碍；报告期内，公司内部控制健全，且得到了有效执行；截至本反馈意见回复签署之日，公司控股股东、实际控制人不存在其他未履行相关承诺的情形。

6、根据申请材料，申请人客户集中度较高，且公司出口美国的部分产品在美国加征关税的商品目录中。请申请人结合中美贸易摩擦的最新情况，补充披露：（1）对前五大客户的销售产品、销售收入及其占比等情况，客户集中度较高是否属于行业惯例，是否存在对主要客户的重大依赖；（2）公司前五大客户的开发方式及合作历史，是否存在长期的业务合作协议或特殊利益安排或关联关系，是否存在随时被取代的风险；（3）报告期内公司境外销售产品、销售收入及其占比等情况，对美国出口产品及其销售收入情况，中美贸易摩擦对公司生产经营是否存在重大不利影响。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

回复：

发行人已在《募集说明书》“第四节 公司基本情况”之“八、公司主营业务的具体情况”之“（四）公司主要业务的生产和销售情况”和“十一、境外经营

情况”补充披露以下内容：

一、对前五大客户的销售产品、销售收入及其占比等情况，客户集中度较高是否属于行业惯例，是否存在对主要客户的重大依赖

（一）公司对前五大客户的销售产品、销售收入及其占比情况

报告期内，公司向前五大客户的销售产品、销售收入及其占比情况如下：

单位：万元

报告期	序号	客户名称	销售产品	销售收入	占比
2019 年 1-6 月	1	客户一	印制电路板、 电子装联、其他	134,600.52	28.09%
	2	客户二	印制电路板、其他	61,667.44	12.87%
	3	客户三	印制电路板、 电子装联、其他	15,849.71	3.31%
	4	客户四	印制电路板、 电子装联、其他	14,123.01	2.95%
	5	客户五	印制电路板、电子装联	11,538.19	2.41%
	合计			237,778.87	49.62%
2018 年度	1	客户一	印制电路板、 电子装联、其他	188,207.43	24.76%
	2	客户二	印制电路板、 电子装联、其他	52,275.01	6.87%
	3	客户三	印制电路板	24,635.84	3.24%
	4	客户四	印制电路板、 电子装联、其他	22,982.13	3.02%
	5	客户五	印制电路板、电子装联	21,876.64	2.88%
	合计			309,977.05	40.77%
2017 年度	1	客户一	印制电路板、电子装联	127,623.09	22.44%
	2	客户二	印制电路板、 电子装联、其他	40,346.86	7.09%
	3	客户三	印制电路板、电子装联	17,109.63	3.01%
	4	客户四	印制电路板、 电子装联、其他	16,614.50	2.92%
	5	客户五	印制电路板	15,168.59	2.67%
	合计			216,862.67	38.13%
2016 年度	1	客户一	印制电路板、电子装联、封 装基板、其他	133,772.73	29.09%

报告期	序号	客户名称	销售产品	销售收入	占比
	2	客户二	印制电路板、其他	39,210.60	8.53%
	3	客户三	印制电路板、电子装联	19,797.24	4.31%
	4	客户四	印制电路板	13,907.81	3.02%
	5	客户五	印制电路板、电子装联	11,050.14	2.40%
	合计			217,738.52	47.35%

注：前五大客户统计口径包含其同一控制下的企业。

如上表所示，报告期内，发行人对前五大客户合计销售收入占同期公司销售收入的比重分别为 47.35%、38.13%、40.77%及 49.62%，不存在对单一客户销售金额超过 50%等严重依赖于少数客户的情况。

（二）关于发行人客户集中度与同行业上市公司对比的情况

最近三年，公司及同行业可比上市公司前五大客户销售收入占比情况如下：

证券代码	证券简称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
002938.SZ	鹏鼎控股	83.19%	81.11%	79.04%
002913.SZ	奥士康	30.70%	26.64%	29.82%
300739.SZ	明阳电路	45.71%	44.02%	42.48%
603328.SH	依顿电子	43.61%	40.27%	42.42%
002463.SZ	沪电股份	66.49%	69.17%	73.24%
603228.SH	景旺电子	23.95%	23.68%	23.31%
002815.SZ	崇达技术	25.22%	24.29%	25.85%
603936.SH	博敏电子	44.77%	43.24%	40.21%
300476.SZ	胜宏科技	19.13%	18.15%	22.83%
002436.SZ	兴森科技	7.73%	10.15%	9.66%
603920.SH	世运电路	39.23%	47.38%	45.53%
603386.SH	广东骏亚	44.28%	49.29%	56.86%
300657.SZ	弘信电子	86.11%	84.03%	79.11%
平均值		43.09%	43.19%	43.87%
深南电路		40.77%	38.13%	47.35%

如上表所示，2016 年至 2018 年，公司前五大客户合计销售收入占比分别为 47.35%、38.13%及 40.77%，同行业可比上市公司平均水平分别为 43.87%、43.19%及 43.09%。最近三年，公司前五大客户集中度与同行业上市公司平均水平相近，

且 2017 年度、2018 年度均低于同行业平均水平。

二、公司前五大客户的开发方式及合作历史，是否存在长期的业务合作协议或特殊利益安排或关联关系，是否存在随时被取代的风险

(一) 公司前五大客户的开发方式及合作历史

1、前五大客户的开发方式

公司取得客户订单的方式分为直接开发和代理引进两种方式。由于公司生产销售的印制电路板均为定制化产品，在上述两种方式下，公司均直接与客户签订买断式购销合同或确认订单；客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、数量、支付条款、交货时间、送货方式等。

在直接开发方式下，公司销售人员直接与意向客户洽谈并确定合作关系。代理引进方式下，为有效开拓海外市场并提升销售收入，公司通过外部代理商联系部分意向客户。经代理商介绍与客户接洽并确定业务合作关系后，公司直接与客户签署购销合同、确认订单，向其发送货物并进行货款结算；公司与外部代理商另行签署代理协议，约定按照销售回款的一定比例向其支付销售佣金，相关代理商仅提供居间服务。

2、前五大客户的合作历史

公司与前五大客户的合作持续时间均较长，且报告期内向绝大部分前五大客户的销售额呈上升趋势，具体如下：

报告期	前五大客户	合作持续时间
2019 年 1-6 月	客户一	1990 年至今
	客户二	1988 年至今
	客户三	2012 年至今
	客户四	2009 年至今
	客户五	2008 年至今
2018 年度	客户一	1990 年至今
	客户二	1988 年至今
	客户三	2015 年至今
	客户四	2009 年至今

	客户五	2008 年至今
2017 年度	客户一	1990 年至今
	客户二	1988 年至今
	客户三	2005 年至今
	客户四	2010 年至今
	客户五	2015 年至今
2016 年度	客户一	1990 年至今
	客户二	1988 年至今
	客户三	2003 年至今
	客户四	2008 年至今
	客户五	2012 年至今

(二) 公司与前五大客户是否存在长期的业务合作协议或特殊利益安排或关联关系

报告期内，公司通常与客户先签署无固定期限合作框架性协议，客户会定期或不定期地按需向公司发出具体采购订单。客户一般会通过电子邮件方式发来订单，请公司确认具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间、送货方式等内容；公司收到邮件订单后，会在约定时间内经电子邮件回复确认后开始组织安排生产，按照客户订单要求交付生产完工的产品，及时进行货款结算。公司在销售产品过程中，与报告期内前五大客户均不存在特殊利益安排。

公司报告期内的前五大客户均不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的下述法人或者其他组织：1、直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织；2、由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；3、上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；4、持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人；5、中国证监会、深交所或者上市公司认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。综上，公司与报告期内前五大客户均不存在关联关系。

(三) 公司与主要客户合作具有稳定性及可持续性，随时被取代的风险较小

1、公司与主要客户的合作具有稳定性及可持续性

首先，公司作为中国印制电路板行业的龙头企业，主导、参与了多项行业标准的制定，具备较强的综合竞争优势，在研发能力、生产工艺、产品质量、生产规模等方面均能满足现有客户的要求，与主要客户之间始终保持着良好的合作关系。

其次，公司通过多年不断努力，积累了众多优质的客户资源，已成为大批全球领先企业的核心供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。为更好地了解并满足客户的需求，公司在主要客户新产品的研发阶段便能与其进行深度合作，在新产品研发成功后亦能为其提供批量生产，极大地增强了客户粘性。

再者，PCB 产品下游客户尤其是大型客户为保证产品质量、生产规模和效率以及供应链的安全性，对核心零部件采购一般采用“合格供应商认证制度”，要求供应商不仅有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉，而且需要通过严格的认证程序，认证过程复杂且周期较长。公司 PCB 产品下游客户主要分布在通信设备、工控医疗和航空航天等领域，相关客户对 PCB 产品的可靠性、使用寿命、可追溯性等方面技术要求较高，基于此，其对供应商认证较其他客户更为严格。这也意味着，在既定的运营模式下，其更换供应商的转换成本更高，因此，若无特殊情况，下游客户将与 PCB 厂商保持长期规模化合作。公司与部分核心客户的合作年限超过十年，已形成长期战略合作关系。

2、公司通过持续提升核心竞争力，增强与客户的合作稳定性和持续性

(1) 加大研发投入力度，满足客户新产品、新技术的需求

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终坚持自主创新的发展战略，经过多年的自主研发和创新，公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术，从工艺技术到前沿产品开发全方位保持技术的行业领先优势。

随着通信 5G 时代的来临，公司一直积极配合客户开发 5G 无线基站、承载网、核心网等所用的 PCB 产品，为下一代通信网络及设备提供高速、大容量的解决方案。为确保与主要客户合作的可持续性，公司将进一步加大研发投入力度，依托公司领先的研发和技术优势，尽最大努力满足客户现有及未来的产品、技术需求，为双方未来的更进一步深入合作奠定坚实的基础。

（2）适时扩建新增产能，匹配客户的发展需求

通信技术产业发展非常迅速，面对下一代通信网络需求，公司正在加快落实先进产能以适应下游技术发展、满足客户需求。近年来，公司先后在无锡、南通两地投资半导体高端高密 IC 载板产品制造项目及数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目，新增印制电路板 34 万平方米/年和封装基板 60 万平方米/年的生产能力。此外，公司计划通过本次募投项目在南通新建 PCB 工厂，以推进 5G 通信产品、服务器用高速高密度多层印制电路板的规模化生产，提升印制电路板的制造技术能力并扩大产能，加快进入产业化阶段，满足下游市场日益增长的订单需求，进而实现与客户的共赢发展。

（3）强化营运管理能力，保证产品质量可靠性

近年来，公司持续加强对专业化、自动化、信息化工厂建设的投入，建立了高效的信息化管理系统，不断提升运营效率。因在信息化、自动化方面理念先进并大力投入，公司获评工业和信息化部“2018 年两化融合管理体系贯标示范企业”。

公司根据国际标准及实际生产要求建立了完善的规范制度，覆盖各业务产品制造、运营管理等环节。通过标准化操作并借助各类 IT 系统，规范并持续优化业务处理流程，保证每项业务和制造流程的每个环节均处于可控状态。公司已先后通过 ISO9001、ISO14001、IATF16949:2016、AS9100、OHSAS18001、ISO27001、ISO13485 等管理体系认证，拥有健全有效的质量管理体系，有效保障了产品质量的长期稳定提升。

公司积极推进管理创新，在不断成长的过程中进行了一系列管理变革，逐步与国际接轨。自 2007 年以来，公司积极推行精益六西格玛、平衡计分卡等先

进管理理念及工具，为持续优异运营提供强有力的保障。

综上，公司同主要客户的交易具有稳定性及可持续性，随时被取代的风险较小。

三、报告期内公司境外销售产品、销售收入及其占比等情况，对美国出口产品及其销售收入情况，中美贸易摩擦对公司生产经营是否存在重大不利影响

(一) 报告期内公司境外销售情况及对美国的销售情况

报告期内，公司境外销售产品、销售收入及其占比情况如下：

单位：万元

地区	2019 年 1-6 月			2018 年度		
	销售产品	销售收入	占比	销售产品	销售收入	占比
境外销售	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	154,004.42	33.12%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	272,771.04	37.11%
其中： 亚洲	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	96,147.98	20.68%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	165,391.72	22.50%
欧洲	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	35,275.13	7.59%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	72,056.36	9.80%
北美洲	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	21,739.09	4.67%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	32,907.10	4.48%
南美洲	印制电路板	734.15	0.16%	印制电路板	2,415.45	0.33%
大洋洲	印制电路板	108.07	0.02%	印制电路板	0.41	0.00%
境内销售	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	311,007.67	66.88%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	462,243.86	62.89%
总计		465,012.09	100.00%	-	735,014.90	100.00%
地区	2017 年度			2016 年度		
	销售产品	销售收入	占比	销售产品	销售收入	占比

境外销售	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	207,717.37	38.11%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	151,924.38	34.49%
其中： 亚洲	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	131,946.56	24.21%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	96,980.82	22.01%
欧洲	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	51,542.58	9.46%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	33,181.81	7.53%
北美洲	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	23,199.11	4.26%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	16,336.00	3.71%
南美洲	印制电路板	1,020.21	0.19%	印制电路板	5,383.33	1.22%
大洋洲	印制电路板	8.9	0.00%	印制电路板	42.42	0.01%
境内销售	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	337,344.38	61.89%	印制电路板、 电子装联、 封装基板、 其他	288,609.91	65.51%
总计		545,061.75	100.00%	-	440,534.29	100.00%

报告期内，公司境外销售的产品以印制电路板为主，销售区域主要集中在亚洲、欧洲和北美洲等地区，其中对美国出口销售收入分别为 15,082.98 万元、18,765.48 万元、29,098.04 万元和 18,227.06 万元，占同期销售收入的比重分别为 3.42%、3.44%、3.96%和 3.92%，整体占比较小。

（二）中美贸易摩擦对公司生产经营不存在重大不利影响

截至目前，中美经贸摩擦的发展历程如下：

时间	主要事件
2018 年 6 月	美国白宫宣布对从中国进口的 500 亿美元商品征收 25%的关税
2018 年 9 月	中国依据世贸组织争端解决机制的相关规定，向世贸组织提出贸易报复授权申请，提出对美方实施每年约 70.43 亿美元的贸易报复
	美国贸易代表办公室对外宣布向中国实施征收价值约 2,000 亿美元的正式贸易关税清单
	国务院新闻办公室发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，旨在澄清中美经贸关系事实，阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场，推

时间	主要事件
	动问题合理解决
2018 年 12 月	中美两国元首在 G20 峰会上达成共识，同意停止加征新的关税
2019 年 2 月	美国总统特朗普宣布，推迟 3 月 1 日上调中国输美商品关税的计划
2019 年 4 月	刘鹤副总理初应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商
2019 年 5 月	美方将对 2,000 亿美元中国输美商品加征的关税从 10%上调至 25%
	国务院关税税则委员会发布国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率的公告
2019 年 6 月	在 G20 大阪峰会上，中美领导人同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商；本轮会谈中，美方表示谈判期间不对中国产品加征新的关税，两国经贸团队，将就具体问题进行讨论
2019 年 8 月	美方拟对 3,000 亿美元中国输美商品加征 10%关税
	国务院关税税则委员会对 8 月 3 日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品
	国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的 5078 个税目、约 750 亿美元商品，加征 10%、5%不等关税
	美方宣布将提高对约 5500 亿美元中国输美商品加征关税的税率

资料来源：公开信息整理

如上表所示，中美经贸摩擦属于双边贸易发展衍生的结果，当前中美经贸摩擦给产业、经济运行均带来较大不确定性。目前，公司相关客户订单量依然处于正常状态，公司生产经营环境未发生重大不利变化，中美贸易摩擦未对公司生产经营产生重大不利影响，但若中美贸易摩擦不断升级，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。

目前，公司涉及美国的原材料占同类原材料采购量的比重较小，公司销往美国的销售收入占营业收入的比重亦较小。公司持续跟踪中美经贸摩擦的最新进展，并拟定相应预案：一方面，公司正加紧研究部分重要原材料的替代方案，以应对中美贸易摩擦升级带来的不利影响；另一方面，公司密切关注相关厂商的订单量变化，适时根据客户需求变化调整市场策略，加大对其他境外市场的开拓。

综上所述，中美经贸摩擦短期内不会对公司生产经营带来重大不利影响，但若中美经贸摩擦再度升级，公司部分美国客户可能会减少从中国进口，转而向其他国供应商采购，将会导致公司对美国的出口销量下降，对公司的出口收

入、主营业务盈利等带来一定程度的不利影响。

四、保荐机构和发行人律师核查情况

（一）核查方式

1、取得了发行人报告期内主要客户的销售合同、收入成本明细表、客户询证函、同行业可比公司的定期报告等资料；

2、对发行人主要高管、业务负责人进行了访谈、实地走访了主要生产经营场所等；

3、查阅近期中美经贸摩擦进展相关资料，查阅公司出口美国商品报关单及商品编号并与美国贸易代表办公室发布的贸易关税清单进行比对；

4、查阅和分析发行人境外销售数据等资料，对发行人相关人员进行访谈。

（二）保荐机构和发行人律师核查意见

经核查，保荐机构、发行人律师认为：报告期内，发行人主要客户较为稳定，不存在严重依赖于少数客户的情况；最近三个会计年度，发行人前五大客户集中度整体呈下降的趋势，且 2017 年度、2018 年度均低于同行业平均水平。发行人前五大客户集中度水平与同行业上市公司较为接近，符合行业惯例。报告期内，发行人主要通过直接开发、代理引进两种方式获取客户，主要客户进入和退出以及金额发生变化主要基于客户对下游市场需求、产品质量、生产能力等因素综合判断所做出的市场化选择，发行人与报告期内前五大客户均不存在特殊利益安排，与报告期内前五大客户不存在关联关系。发行人主要客户稳定，与发行人合作年限较长，且发行人多为其核心供应商。发行人向主要客户的销售具有可持续性，随时被取代的风险较小。

中美经贸摩擦的目前发展形势未对公司生产经营产生重大不利影响。但是，如果中美经贸摩擦继续升级，公司部分美国客户可能会减少从中国进口，转而向其他国供应商采购，将会导致公司对美国的出口销量下降，对公司的出口收入、主营业务盈利等带来一定程度的不利影响。

7、报告期内，申请人及其下属子公司存在部分房屋暂未取得《房屋所有权证》。请申请人补充披露其最新进展情况。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

回复：

发行人已在《募集说明书》“第四节 公司基本情况”之“九、公司固定资产及无形资产情况”之“（一）发行人主要固定资产”之“4、暂未取得《房屋所有权证》的生产经营性房屋”补充披露以下内容：

一、发行人及其下属子公司部分房屋取得《房屋所有权证》最新进展情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司暂未取得产权证书的生产经营性房屋情况如下表所示：

序号	房屋名称	坐落位置	建筑面积	用途
1	N7#楼厂房	南通高新区希望大道 168 号	36,378.19 m²	生产厂房
2	N6#楼厂房	南通高新区希望大道 168 号	9,395.06 m²	生产辅助楼
3	N13#楼厂房	南通高新区希望大道 168 号	5,425.18 m²	清洁中心
4	N14#楼厂房	南通高新区希望大道 168 号	541.71 m²	甲类仓库
5	N4-4#楼宿舍	南通高新区希望大道 168 号	9,210.79 m²	宿舍
6	厂房门卫 M2	南通高新区希望大道 168 号	104.33 m²	门卫
7	厂房门卫 M3	南通高新区希望大道 168 号	58.12 m²	门卫

上述房屋系南通深南新建房产，2019 年 1 月 20 日，公司已于南通市通州区行政审批局完成竣工验收备案。截至本反馈意见回复签署之日，上述房产的不动产登记权证正在办理过程中。

二、保荐机构和发行人律师核查情况

（一）核查方式

1、获取了截至 2019 年 6 月 30 日公司暂未取得产权证书的生产经营性房屋明细、建设工程施工许可、竣工验收资料；

2、南通深南出具的关于不动产登记权证办理进展情况的说明，了解暂未取得产权证书的房屋的基本情况权证办理进展。

（二）保荐机构和发行人律师核查意见

经核查，保荐机构和发行人律师认为：南通深南上述暂未取得产权证书的生产经营性房屋的不动产登记权证正在办理过程中，相关房屋取得权属证书不存在法律障碍。

（本页无正文，为深南电路股份有限公司《关于深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》之盖章页）

深南电路股份有限公司

年 月 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读深南电路股份有限公司本次反馈意见回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：_____

杨德红

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于深南电路股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》之盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 许 磊 张 力

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读深南电路股份有限公司本次反馈意见回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：_____

王晓峰

中航证券有限公司

年 月 日

（以下无正文，为中航证券有限公司《关于深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》之盖章页）

保荐代表人：_____

孙 捷 阳 静

中航证券有限公司

年 月 日